

めつきプロセス開発

ガラスコア基板向け

奥野製薬工業株（大阪市）は、ガラスへの高密着めつきプロセス「TO RIZING（トライジン

グ「プロセス」を開発し、ガラスコア基板向けスルーホールフーリング硫酸銅めつき添加剤「トップルチナGCSシリーズ」とともに提案を進め。12月17～19日に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan」では「見え

らに、スルーホールフイリング用硫酸銅めっき添加剂のトップルチナGCSシリーズは、ボイドフリーを実現したほか銅充填に必要なめつき処理時間を大幅に短縮することができる。これら銅めつきを施したら510×515 mmのガラス基板を展示する。

生産性の向上に寄与する。
また、ウエハー向けには
銅と銅のハイブリッド接合
用硫酸銅めっき添加剤「TO-
RYZA LCN LXD」やコロ
M形成用無電解めっきアロ
ヤム「TORYZA EL PROC
ESS」などの新装装置
「TORYZA EL SYSTEM」
を紹介する。ニッケル皮膜
中のリン濃度を大幅に低下

の皮膚への負荷に対応する
もので、次世代パワー・デバイス
向けなどに適する。
そのほか、ウエハ一向け
銅めつき添加剤「TORY
ZA LCNシリーズ」の
既存製品などを展示し、半
導体に関わる幅広いライン
アップを紹介する。

そのほか、ウエハ一向け銅めつき添加剤「TORRY ZA LCNシリーズ」の既存製品などを展示し、半導体に関する幅広いラインアップを紹介する。また、最新技術として開発

への銅めっき充填において
求められる高アスペクト比
のスルーホール基板に対応
する高密着めつきプロセス
のTORIZINGプロセ
スを開発。基板サイズ51
 0×515 mm、厚さ800
 μ m、穴径75 μ mの大型基
板への対応も実現した。さ

銅めつき添加剤「トップアルチナNSV LV」を紹介する。ADVは、ハイエンド向けの微細配線や小径ビアのフリーリングが可能である。一方LVは、MSAPなど大口径ビアでの使用に適する。電流密度の向上と膜厚の均一性を両立させ、

させたことで耐熱性が向上し、実装時のクラックの減少に貢献する。高温実装で

i-X(株)と共同開発を進めており、 $r-\text{GeO}_2$ の成膜時における蒸着イメージのデモを行つ。

